

JENNIFER LIEB

□□□

□□□□

一片晶圆最多可制造出数千颗独立芯片。

□此过程中，测量系统会定□对质量进行检□———□中同□会□到激光技术。首先在□造□程中进行检测，随后在负□和温度条件下进行测试。这一点至关重要，因为即□是□微小的缺陷，也可能导致□含数百万颗芯片的整批产品报废。

□最后一层完成后，激光就□将晶圆分割成数百甚至数千个单独芯片。随后，这□芯□会被逐一安装到电路板上□并封装于保护外壳中。在此期间，激光还发挥着辅□作□，例如用于接点开窗、焊□导线或标记序列号。经过最终检测后，这□□小的元器件最终会以成品□芯片的形式，应用于智能手机、汽车或医疗设备之□。

□□□通□在□导□□□□□解□方□

□有通□，就没有人工智能。我□的激光和等离子解决方案□现□半导体制造的支柱。从 EUV 光刻技术到先进□封□技术：只要是创造未来的□方，就会用到我们的技术。无□是□积、曝光还是蚀刻———□是追□创新与进步的地方，都离不开通快。与此同时，我□更□一步思考：我们的解决方□不仅要实现卓越性能，也要兼顾资源高□利用的生□工□。携手实力强大□技术合作伙伴，我们不断□动□新，重塑整个行业。 了解更多

JENNIFER LIEB

通快集团公关部门

https://www.trumpf.com/zh_INT/newsroom/stories/%E5%BE%AE%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8%E9%80%9A%E5%BF%AB%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%B8%8B%E8%AF%9E%E7%94%9F/